# 携帯電話用パワー マネージメントICの 選択

スマートで高機能な新世代の携帯電話が販売店の陳列台にあふれている。これらの最新型携帯電話は、これまでの世代のものに比べて小型化されているだけでなく、PDA機能、電子メール、インスタントメッセージの送受信、ウェブサイトの閲覧が、さらに大型化された高精細ディスプレイで可能となっている。機種によっては、FMラジオ、MP3プレーヤ、またはかなりの品質のディジタルカメラまでついている。これだけの機能を搭載しているにもかかわらず、消費者は長時間のバッテリ寿命を要求し、サイズは小型のものを期待している。小型化を続ける箱の中により多くのものを詰め込もうとし、同時に消費電力を抑えようとするとなると、電源設計が重要な役割を担ってくる。この難題をクリアするためにアナログICメーカーは、より小型で高性能な電源ソリューションの開発を続けている。

## パワーマネージメントIC

大半の無線端末の心臓部ではパワーマネージメント IC (PMIC)が鼓動している。PMICは電源供給に必要な条件 を満足させるだけでなく、インタフェースやオーディオ など他のブロックも扱う。主要なアナログ半導体メーカー は、多くの場合、ミックスドシグナル及びパワーサプライ に最適化された5VのサブマイクロンBiCMOSプロセスを 用いて、PMICをフルカスタム、セミカスタム、標準品 として提供している。端末内部の他の部分で集積化され ていない個別ブロックがあるとすれば、それはPMICに 集積できる可能性がある。しかし、図1のとおり制限も ある。ブロックの中には次のような理由で集積化しない ほうがよい場合もある。それは、1)他のプロセスで設計 したほうが低コストまたは小型にできる、2)技術の進歩、 またはカスタマの仕様の変更によって設計が変わる可能性 がある、3) 全プラットフォームに1つのブロックが共通化 できない、4) 大幅な設計変更によって開発スケジュール にリスクが生じる、5) ノイズ結合など性能的な理由で 集積化に適していない、などである。

可能な限り多くを集積しようとする理由は、コストとサイズが目に見えて節約できることであり、特にその集積化が大多数の端末に一般的なものであればなおさらである。リスク管理は、段階的に集積度合を徐々に拡大していくことで対応する。

## 低ドロップアウト・リニアレギュレータ

携帯電話端末は、標準的に5~12個の低ドロップアウト (LDO)リニアレギュレータが必要である。これだけ多く

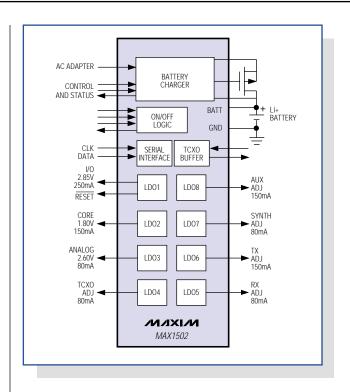


図1. 低リスク、最低限の集積化の一例。標準品のパワーマネージメントIC として投入されたMAX1502は、主なCDMAチップセットをサポート するのに必要な最も一般的なブロックのみを集積化している。

の数が必要なのは、これだけ多くの数の電圧があるから ではなく、LDOがオン/オフ用スイッチとして動作し、 ノイズ結合を防止する電源ノイズ除去比(PSRR)を備え ているからである。ほとんどのLDOはPMICに内蔵され ているものの、基板のレイアウト/配線、電圧制御発振器 など特定部品のノイズ感度、または内蔵ディジタルカメラ など標準でないブロックへの電源供給の理由で少数の ディスクリートLDOが残ることになる。ディスクリート の場合、これまで一般的に使われていたのはシングル、 150mA、SOT23パッケージのLDOだった。現在では、 パッケージが進化し、プロセスが1マイクロンを切る サブマイクロン時代になり、設計技術も向上したことから、 性能が上がり、パッケージも小型化された。たとえば、 300mA、SOT23のシングルLDOや、150mA、SOT23 のデュアルLDO、または120mA、超小型SC70のシングル LDOなどが提供されており、これらには標準版と低ノイズ 版(10µV<sub>RMS</sub>、85dBのPSRR)がある。さらに、最新の ウルトラ・チップスケールパッケージ(UCSP™)では限界に 近い小型サイズが可能になり、新型QFNパッケージでは、 これまでにない最大のダイサイズのプラスチックパッ ケージ封止が可能で、3mm x 3mmの実装面積に最高の 放熱効率が実現している。このため、QFNパッケージで はLDOの電流値や、1パッケージ内の回路数の増加が 可能となる。LDOには3回路、4回路、5回路入りのもの もあり、これらはディスクリート構成とPMICの間の ギャップを埋める役割を担う。

UCSPはMaxim Integrated Products, Inc.の商標です。

## プロセッサコア用 ステップダウン(バック)コンバータ

LDOがシンプルで小型になると、弱点として懸念される のが効率であり、特に低電圧回路駆動ではそれが顕著に なる。携帯電話においてPDAやインターネットの機能が 強化されるにつれて、よりパワフルなプロセッサが、 1.8 Vから0.9 Vという過去に例をみない低電圧の電源 電圧範囲で使われている。バッテリ電流を抑えるために、 高効率のステップダウン・スイッチングレギュレータが コアに給電するのがよい。関心は、低コスト、小型サイズ、 高効率、低自己消費(スタンバイ)電流、及び高速過渡 応答にある。これだけの厳しい条件をすべて満足するに は熟練のアナログ設計とちょっとした工夫が必要である。 今日、小型の外付けインダクタ及びセラミックコンデンサ が使えるように1MHzまたはそれ以上のスイッチング スピードで動作するSOT23入りの小型バックコンバータ を提供しているのは、一握りのトップアナログ半導体 メーカーだけである。

## RFパワーアンプ用 ステップダウン(バック)コンバータ

成熟した日本の携帯電話市場では、基地局からの距離に 応じてVCC供給電圧を調節するCDMA無線部のパワー アンプ(PA)の給電にもバックコンバータが使われて いる。バックコンバータは、送信の確率密度関数を掛け ると、出力電圧の段数、PAの特性、及び都市または郊外 エリアで音声送信するかデータ送信するかに応じて平均 40mA~65mAのバッテリ電流を節約することができる。 日本での成功(及び欧州のあるイノベータがWCDMAに 投入した先駆者的な努力)を受けて、韓国、アメリカ、及び 他の欧州の携帯電話メーカーがスイッチングレギュレータ を検討、もしくはそれを採り入れて設計を行っている。 バックコンバータの優先順位は、小型サイズ、低コスト、 低出力リップル、そして高効率である。先にも述べたが、 SOT23のコンバータは良い選択と言える。ドロップアウト をできるだけ小さく抑えるために、ハイパワー送信時には、 ディスクリートで低R<sub>DS(ON)</sub>のPチャネルMOSFETが、 バッテリからPAへの直接給電でよく使われる。最新の ステップダウンコンバータ(たとえばMAX8500ファミリ など)は、全体のサイズをさらに削減するために、この 追加FETを内蔵している。

### LED全盛時代

カラーディスプレイを備えた無線端末では、白色LEDが 回路のシンプルさと信頼性の高さゆえに、バックライト アプリケーションを独占している。効率ではハロゲンを 上回るものの、蛍光灯にはまだ及ばない。現在の設計で は通常3個か4個の白色LEDをメインディスプレイに、 2個のLEDをサブディスプレイに使い(折り畳み式端末 設計の場合)、6個かそれ以上の白色またはカラーLEDを キーボードの裏に使っている。カメラ内蔵の場合、フラッ シュ/ストロボ及びMPEG動画ライト用にさらに4個の白色LEDを使用しているようである。1つの端末で最大16個のLEDを使用していることになり、すべてのLEDは定電流で駆動する必要がある。

何年も前に、日本の第1世代のカラー端末は、効率の 低い1.5倍圧チャージポンプとバラスト抵抗を使っていた。 (そのソリューションでは、PAにバックコンバータを 導入して苦労して節約した40mAを事実上浪費していた のである。)今日、大半の設計は、はるかに高い効率を 得るためにインダクタベースのブーストコンバータに なっている。しかし、最新型の1倍圧/1.5倍圧チャージ ポンプは、LEDへの配線が増えるという点はあるが、 インダクタなしで同様な高効率を得ることができる。 白色LED用電源の市場は非常に大きいため、驚くほど 多くのICが入手できる。ここでの関心事は、高効率、 外付け部品の小型化、(他の回路にノイズの回り込みを 避けるために)低入力リップル、シンプルな調光用インタ フェース、その他、出力過電圧保護などコスト削減 または信頼性向上につながる機能である。PMICの中に は白色LED用電源を内蔵しているものがあるが、ほとん どの場合、複数のディスプレイやカメラのストロボに 対応していないことが多く、効率が不十分であったり、 スイッチングが遅すぎるためインダクタやコンデンサが 大きくなり、過度の入力リップルが発生する。このため、 多くの場合、PMICにディスクリートICを追加したり、 ディスクリートソリューションの中でもかなり集積度の 高いもの(たとえばMAX1582など、図2を参照)を探す 必要がある。

### バッテリ充電

ほとんどすべての無線端末は3セルのニッケル水素 (NiMH)または1セルのリチウムイオンバッテリを、シン プルなリニアチャージャで充電している。ほとんどの場合、 チャージャはPMICの中に取り込まれており、複雑になる のを避けるために電流検出抵抗やパストランジスタは 外付けになっていることが多い。発熱を抑制するには オプションがいくつかある。1) C/4またはそれより低速 で充電する、2) 電圧降下がほとんどACアダプタで起こる ようにACアダプタの出力に多少抵抗性を持たせる、 4) フィードバックを持たせてパストランスタの電圧降下が 一定になるようにACアダプタを安定化させる、5)チップ 温度を一定に維持するために電流を減らす固定温度制御 ループを追加することであるが、これはパストランジスタ がPMICに内蔵されている場合にのみ実用的となる。 ディスクリートのチャージャICもフレキシビリティの点 では良いが、携帯電話においてはメリットが半減してし まう。なぜなら、内蔵チャージャであれば、PMICの シリアルインタフェースを介して再プログラミングが 容易であり、様々なバッテリタイプや容量に対応する からである。

Connecting Industry (UK)の2003年5月号にも同様の記事が掲載されています。

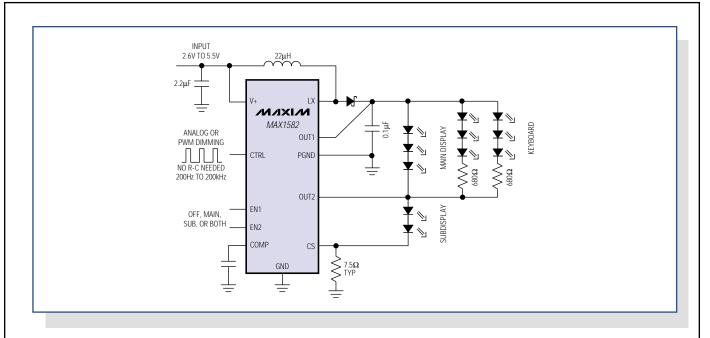


図2. 端末の中でLEDのバックライトはバッテリ電力を最も多く消費する部分の1つであるため、MAX1582は高効率ブーストコンバータトポロジを採用し、 メインディスプレイ、サブディスプレイ、及びキーボードを点灯させている。